#### PCB 板材厚度规格:

 $0.5 \, \mathrm{mm}, \ 0.7 \, \mathrm{mm}, \ 0.8 \, \mathrm{mm}, \ 1.0 \, \mathrm{mm}, \ 1.2 \, \mathrm{mm}, \ 1.5 \, \mathrm{mm}, \ 1.6 \, \mathrm{mm}, \ 2.0 \, \mathrm{mm}, \ 2.4 \, \mathrm{mm}, \ 3.2 \, \mathrm{mm}, \ 6.4 \, \mathrm{mm}$ 

#### PCB 板上铜箔的厚度规格:

18um, 25um, 35um, 70um 和 105um

#### 常用半固化片规格:

型号	1080	2116L	2116A	2116H	1500	7628L	7628A	7628H	7628M
厚 mil	3	4	4.5	5	6	7	7.5	9.3	8

## 板厚一般分为含铜和不含铜两种厚度

#### 一. 含铜厚度:

	规格	×: 配料结构		规格	配料结构
0.1	H/H	1×106		1/1	<u>6×7628</u>
	1/1	1×2116	1.3	H/H	7×7628
	H/1	2×1080		2/2	7×7628
0.2	H/H	1×1506	1.4	1/1	7×7628
	T/T	1×7628		H/H	7×7628
	2/2	1×106		2/2	7×7628
	2/2	1×1506	1.5	1/1	8×7628
	H/2	1×7628	1.5	H/H	8×7628
0.3	1/1	2×2116		T/T	8×7628
0.3	H/1	2×2116		2/2	8×7628
	H/H	1080+2116+1080	1.6	1/1	8×7628
	T/T	1080+2116+1080		H/H	8×7628
	2/2	1080+2116+1080		2/2	9 > 7629
0.4	1/1	1080+7628+1080	1.7	2/2	<u>8×7628</u>
0.4	H/H	2×7628	1./	1/1	9×7628
	T/T	2×7628		H/H	9×7628
	2/2	2×7628		2/2	9×7628
0.5	1/1	7628+1080+7628	1.8	1/1	9×7628
	H/H	7628+1080+7628		H/H	<u>9×7628</u>
	2/2	7628+1080+7628		2/2	9×7628
0.6	1/1	$3 \times 7628$	1.9	1/1	$10 \times 7628$
	H/H	3×7628		H/H	$10 \times 7628$
	2/2	3×7628		2/2	$10 \times 7628$
0.7	1/1	$2116+2 \times 7628+2116$	2.0	1/1	<u>10×7628</u>
	H/H	$1080+3 \times 7628+1080$		H/H	$11 \times 7628$
	2/2	$1080+3 \times 7628+1080$	2.2	1/1	<u>11×7628</u>
0.8	1/1	4×7628	2.2	H/H	$12 \times 7628$
	H/H	4×7628		2/2	12×7628
	2/2	4×7628	2.3	1/1	12×7628
0.9	1/1	$2 \times 7628 + 1080 + 2 \times 7628$		H/H	12×7628
	H/H	$2 \times 7628 + 2116 + 2 \times 7628$		2/2	12×7628
	2/2	$2 \times 7628 + 2116 + 2 \times 7628$	2.4	1/1	13×7628
1.0	1/1	5×7628		H/H	13×7628
	H/H	5×7628		2/2	13×7628
	2/2	5×7628	2.5	1/1	13×7628
1.1	1/1	<u>5×7628</u>		H/H	13×7628
	H/H	6×7628		2/2	16×7628
	2/2	6×7628	3.0	1/1	16×7628
1.2	1/1	6×7628		H/H	16×7628
	H/H	6×7628	3.2	1/1	17×7628
			3.2	2/2	17×7628

## 二. 不含铜厚度

厚度 mil	厚度 ㎜	配料结构	备注
2	0.050	1×106	不含 20Z 铜箔
3	0. 075~0. 076	主:1×1080 次:1×1086	不含 20Z 铜箔
厚度 mil	厚度 ㎜	配料结构	备注
4	0. 10~0. 102	主:1×2116次:1×3313或2×106或1×2113或1×2313或1080+106	
5	0. 127	主:1×2116 次:2×1080	
6	0. 150~0. 152	主:1×1506 次:2×1080	
7	0. 178	主:1×7628 次:1080+2116	
8	0. 200~0. 203	主:1×7628 次:2×2116 或 2×2113	
9	0. 228~0. 230	2×2116	
10	0. 25~0. 254	2×2116	
11	0. 280	主:1080+2116+1080 次:2×2165	
12	0. 300~0. 305	主:2×1506 次:2116+1080+2116	
13	0. 33	主:1080+7628+1080 次:2×1506	
14	0. 356~0. 36	2×7628	
15	0. 38	2×7628	
16	0. 406~0. 41	主:2×7628 次:3×2116	
17	0. 43	主:7628+1080+7628 次:2×7628	
18	0. 457~0. 46	7628+1080+7628	
19	0. 48	7628+2116+7628	
20	0. 508~0. 51	主:7628+2116+7628 次:7628+2×1080+7628 或 3×7628	
21	0. 53	3×7628	
22	0. 56	3×7628	
23	0. 58	3×7628	
24	0.60~0.61	主:3×7628 次:2116+2×7628+2116	
25	0.64	主:3×7628 次:2116+2×7628+2116	
26	0. 66	1080+3×7628+1080	
27	0. 69	1080+3×7628+1080	
28	0. 71~0. 711	主:4×7628 次:4×7628	
30	0. 76	$4 \times 7628$	
31	0. 79~0. 80	$4 \times 7628$	

## 友情备注:

1 foot = 12 inch = 304.8 mm

1inch = 25.4 mm

1 mil=0.0254 mm

1 inch=1000 mil

1OZ=28.375g 1 OZ 铜箔其真正厚度为 1.38mil 或 35 μ m

- 一、芯板、半固化片规格:
- 1. 生益芯板常见规格:
  - 0.1mm (含铜厚)
  - 0.2mm~5.12
  - 0.3mm~9.06
  - 0.4mm~12.99
  - 0.5mm~16.93
  - 0.6mm~20.87
  - 0.7mm~24.8
  - 0.8mm~28.74
  - 0.9mm~36.61
  - 1mm~44.49
  - 1.2mm~52.36
  - 1.5mm~56.3
  - 1.6mm~60.24
  - 2mm~75.98
  - 2.4mm~91.73
- 2. 半固化片:
  - 1080~3.0mil
  - 2116~4.2mil
  - 7628~7.0mil
- 3. 流胶厚:
  - 1080~2.5mil
  - 7628~6.5mil
  - 0.14mm=2\*1080
  - 0.21mm=2\*2116
  - 0.24mm=7628+1080
  - 0.36mm=2\*7628
  - 0.4mm=2\*7628+1080
- 二、常用半固化片在不同铜厚、不同图形厚度变化:

#### 1. HOZ

	Copper/gnd	Gnd/gnd	Copper/signal	Gnd/signal	Signal/signal
7628	7.3	7.0	6.8	6.7	6.6
2116	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8
3313	3.9	3.8	3.7	3.5	3.3
1080	2.8	2.6	2.5	2.4	2.2
7628H	7.6	7.3	7.1	7.0	6.9
2116H	4.9	4.7	4.5	4.3	4.1
3313H	4.1	4.0	3.9	3.7	3.5
1018H	2.9	2.7	2.6	2.5	2.3
7628C	7.1	6.8	6.6	6.5	6.4
3313C	3.7	3.6	3.5	3.2	3.1

## 2. 1OZ

	Copper/gnd	Gnd/gnd	Copper/signal	Gnd/signal	Signal/signal
7628	7.1	6.8	6.6	6.5	6.4
2116	4.5	4.3	4.1	3.9	3.7
3313	3.8	3.7	3.6	3.4	3.2
1080	2.8	2.6	2.5	2.4	2.2
7628H	7.4	7.1	6.9	6.8	6.7
2116H	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0
3313H	4.0	3.9	3.8	3.6	3.4
1018H	2.9	2.7	2.6	2.5	2.3
7628C	6.9	6.6	6.4	6.3	6.2
3313C	3.6	3.5	3.4	3.2	3.0

## 3. 2OZ

	Copper/gnd	Gnd/gnd	Copper/signal	Gnd/signal	Signal/signal
7628	6.8	6.5	6.3	6.1	6.0
2116	4.2	4.0	3.8	3.5	3.3
3313	3.5	3.4	3.3	3.1	2.8
1080	2.6	2.4	2.3	2.1	1.9
7628H	7.1	6.8	6.6	6.4	6.3
2116H	4.5	4.3	4.1	3.8	3.6
3313H	3.7	3.6	3.5	3.3	3.0
1018H	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0
7628C	6.6	6.3	6.1	5.9	5.8
3313C	3.3	3.2	3.1	2.9	2.6

#### 4. 3OZ

	Copper/gnd	Gnd/gnd	Copper/signal	Gnd/signal	Signal/signal
7628	6.5	6.2	6.0	5.7	5.6
2116	4.0	3.8	3.6	3.2	3.0
3313	3.3	3.2	3.1	2.8	2.5
1080	2.4	2.2	2.1	1.8	1.6
7628H	6.8	6.5	6.3	6.0	5.9
2116H	4.3	4.1	3.9	3.5	3.3
3313H	3.5	3.4	3.3	3.0	2.7
1018H	2.5	2.3	2.2	1.9	1.7
7628C	6.3	6.0	5.8	5.5	5.4
3313C	3.1	3.0	2.9	2.6	2.3

注: Gnd 为 65%以上的大铜箔, H 为高树脂含量, C 为低树脂含量。

# S0401 粘结片压合厚度(100%残铜率)

指标规格	树脂含量	压合厚度 µm/±20µm	压合厚度 Mil
106	71±3	50	2.0±0.4
1080L	61±3	71	$2.8 \pm 0.4$
1080A	64±3	78	$3.1 \pm 0.4$
1080H	68±3	90	$3.5 \pm 0.4$
2116L	50±3	113	$4.4 \pm 0.6$
2116A	52±3	120	4.7±0.6
2116H	56±3	133	5.2±0.6
3313	55±3	100	$4.0 \pm 0.6$
7628L	41±3	185	$7.3 \pm 0.8$
7628A	43±3	195	$7.7 \pm 0.8$
7628M	46±3	210	$8.3 \pm 0.8$
7628H	50±3	230	$9.1 \pm 0.8$
1506A	45±3	160	$6.3 \pm 0.8$
1506H	49±3	175	$6.9 \pm 0.8$

S0701 粘结片压合厚度 (残铜率 100%)

指标规格	树脂含量	压合厚度 µm/±20µm	压合厚度 Mil
106	71±3	51	2.0±0.4
1080L	61±3	72	$2.8 \pm 0.4$
1080A	64±3	80	$3.1 \pm 0.4$
1080H	68±3	92	$3.6 \pm 0.4$
2116L	$50\pm3$	115	4.5±0.6
2116A	52±3	121	4.8±0.6
2116H	56±3	135	$5.3 \pm 0.6$
3313	55±3	102	4.0±0.6
7628L	41±3	188	$7.4 \pm 0.8$
7628A	43±3	198	$7.8 \pm 0.8$
7628M	46±3	213	$8.4 \pm 0.8$
7628H	50±3	235	$9.3 \pm 0.8$
1506A	45±3	162	$6.4 \pm 0.8$
1506H	48±3	175	$6.9 \pm 0.8$

S1000B 粘结片压合厚度(残铜率 100%)

指标规格	树脂含量	压合厚度 µm/±20µm	压合厚度 Mil
106	71±3	47	1.9±0.4
1080L	63±3	71	$2.8 \pm 0.4$
1080A	66±3	78	$3.1 \pm 0.4$
1080H	68±3	83	$3.3 \pm 0.4$
2116L	52±3	112	$4.4 \pm 0.6$
2116A	55±3	121	$4.8 \pm 0.6$
2116H	58±3	132	$5.2 \pm 0.6$
3313	55±3	94	$3.7 \pm 0.6$
7628L	43±3	185	$7.3 \pm 0.8$
7628A	46±3	198	$7.8 \pm 0.8$
7628M	48±3	207	$8.1 \pm 0.8$
7628H	50±3	218	$8.6 \pm 0.8$
1506A	45±3	151	$5.9 \pm 0.8$
1506H	48±3	162	$6.4 \pm 0.8$

S0155 粘结片压合厚度(100%残铜率)

指标 规格	树脂含量	压合厚度 µm/±20µm	压合厚度 Mil
106	71±3	49	$1.9 \pm 0.4$
1080L	62±3	72	2.8±0.4
1080A	65±3	79	$3.1 \pm 0.4$
1080H	68±3	88	3.6±0.4
2116L	51±3	114	4.5±0.6
2116A	53±3	120	4.7±0.6
2116H	56±3	130	$5.1 \pm 0.6$
3313	56±3	100	$4.0 \pm 0.6$
7628L	42±3	187	$7.4 \pm 0.8$
7628A	44±3	196	$7.7 \pm 0.8$
7628M	46±3	205	$8.1 \pm 0.8$
7628H	50±3	227	8.9±0.8
1506A	45±3	156	$6.1 \pm 0.8$
1506H	48±3	168	6.6±0.8

以上压合厚度谨供贵司参考,因为具体压合后厚度还与贵司生产的 PCB 的铜厚、线路等有关,所以以上数据仅为贵司提供一个参考,制成 PCB 后的具体数据还以贵司实测值为准。